(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203260556 U
(45)授权公告日 2013.10.30

(21)申请号 201320205369.7

(22)申请日 2013.04.22

(73)专利权人 昆山亿业嘉精密机械有限公司
地址 215316 江苏省昆山市玉山镇昆山国际模具城模具制造区 11 号楼 6

(72)发明人 钟旭光

(51)Int.Cl.
H01L 21/56(2006.01)
B29C 33/00(2006.01)

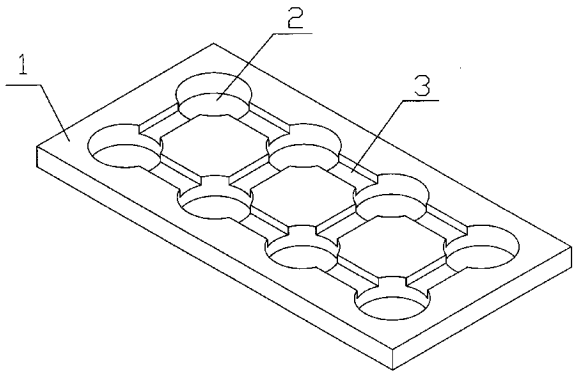
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

封装模具用模窝板

(57)摘要

本实用新型涉及一种封装模具用模窝板，所述模窝板包括板本体，在板本体上开设有若干封装孔，每相邻的封装孔之间设有连接槽；所述的封装孔阵列排列。采用了上述结构之后，因为采用了模窝板结构，能够很好的控制封装液体的凝固位置，并且通过连接槽使得多余的封装液体不会粘连到产品上，提高了产品的使用寿命以及生产效率。



CN 203260556 U

1. 一种封装模具用模窝板，其特征是：所述模窝板包括板本体 (1)，在板本体 (1) 上开设有若干封装孔 (2)，每相邻的封装孔 (2) 之间设有连接槽 (3)。

2. 根据权利要求 1 所述的封装模具用模窝板，其特征是：所述的封装孔 (2) 阵列排列。

3. 根据权利要求 2 所述的封装模具用模窝板，其特征是：所述的封装孔 (2) 为矩形阵列排列或者圆形阵列排列。

4. 根据权利要求 1 所述的封装模具用模窝板，其特征是：所述的连接槽 (3) 内部表面粗糙。

封装模具用模窝板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械行业模具中的一种模板结构，尤其是涉及一种封装模具用模窝板。

背景技术

[0002] 目前，在封装模具行业中，芯片、集成电路以及 LED 都采用封装技术进行保护封装，在使用的时候，封装后的产品使用效果更好，寿命更长，然而现有的封装技术，在封装的时候，封装采用的液体经常会流到不需要封装的部位凝固，这样的产品在使用的时候可能会出现安全问题，从而导致出现次品的概率大大增加，增加了企业的生产成本。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够保证封装液体不会封装在其他部位降低次品的出产概率的封装模具用模窝板。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种封装模具用模窝板，所述模窝板包括板本体，在板本体上开设有若干封装孔，每相邻的封装孔之间设有连接槽。

[0005] 进一步地，为了能够保证封装之后，产品的排列整齐，所述的封装孔阵列排列。

[0006] 进一步具体的，所述的封装孔为矩形阵列排列或者圆形阵列排列。

[0007] 进一步地，为了能够容纳多余的封装液体并且不会粘连在封装产品上，所述的连接槽内部表面粗糙。

[0008] 本实用新型的有益效果是：采用了上述结构之后，因为采用了模窝板结构，能够很好的控制封装液体的凝固位置，并且通过连接槽使得多余的封装液体不会粘连到产品上，提高了产品的使用寿命以及生产效率。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0010] 图中：1、板本体；2、封装孔；3、连接槽。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示一种封装模具用模窝板，所述模窝板包括板本体 1，在板本体 1 上开设有若干封装孔 2，每相邻的封装孔 2 之间设有连接槽 3；所述的封装孔 2 阵列排列；所述的封装孔 2 为矩形阵列排列或者圆形阵列排列，封装孔 2 也可以封装为其他阵列形式；所述的连接槽 3 内部表面粗糙。

[0012] 封装的时候，封装液体流到封装孔 2 以及连接槽 3 内，成型之后留在封装孔 2 和连接槽 3 内，在拿掉模窝板之后，由于连接槽 3 内部表面粗糙，能够使得凝固后的封装液体粘连在连接槽 3 内，保证产品表面的整洁。

[0013] 需要强调的是：以上仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任

何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

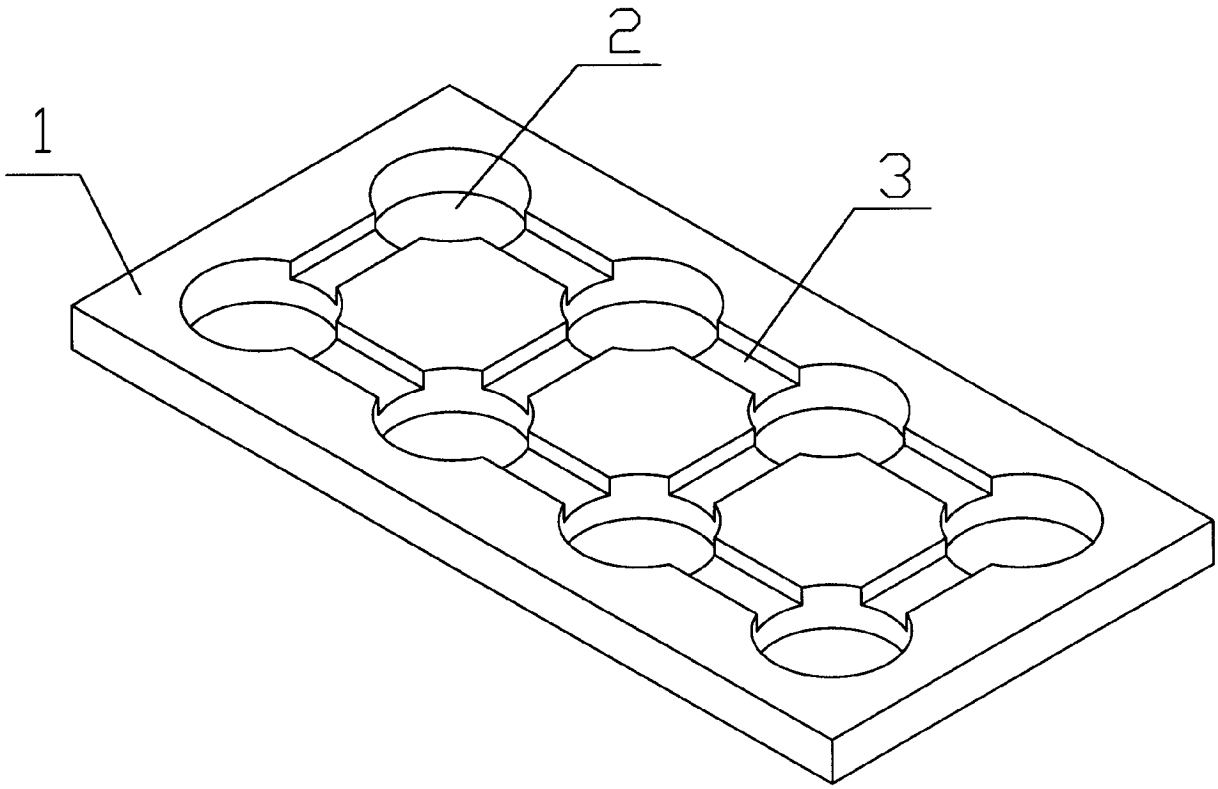


图 1